

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-209065

(43)Date of publication of application : 07.08.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/22
H01L 21/22
H01L 21/3065
// H01L 21/205

(21)Application number : 09-009127

(71)Applicant : KOKUSAI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 22.01.1997

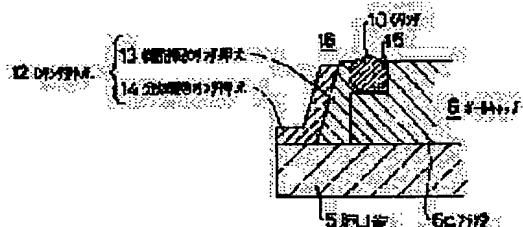
(72)Inventor : YANAGAWA HIDEHIRO

(54) SEMICONDUCTOR MANUFACTURING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent deformation or removal of an O-ring for sealing a furnace aperture of a reaction pipe even after used for a long period of time.

SOLUTION: An O-ring clasper 12 is completed in the double-structure and an O-ring clasper 13 at the internal side which is in contact with a quartz boat cap 6 is formed of an elastic resin such as teflon in order to prevent damages on the boat cap 6. Moreover, an O-ring clasper 14 at the external side of the resin O-ring clasper 13 is formed of a metal material such as stainless steel in order to prevent deformation of the resin O-ring clasper 13.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3601926

[Date of registration]

01.10.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-209065

(43) 公開日 平成10年(1998) 8月7日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	F I
H 0 1 L 21/22	5 1 1	H 0 1 L 21/22
	5 0 1	5 1 1 Q
		5 0 1 D
21/3065		21/205
// H 0 1 L 21/205		21/302
		B

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 3 頁)

(21) 出願番号 特願平9-9127

(22) 出願日 平成9年(1997) 1月22日

(71) 出願人 000001122

国際電気株式会社

東京都中野区東中野三丁目14番20号

(72) 発明者 柳川 秀宏

東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際
電気株式会社内

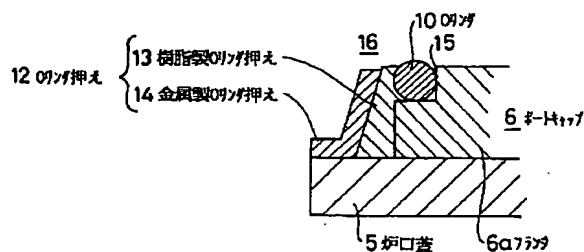
(74) 代理人 弁理士 油井 透 (外1名)

(54) 【発明の名称】 半導体製造装置

(57) 【要約】

【課題】 長時間使用しても反応管の炉口部をシールする
Oリングが変形したり、外れたりしないようにする。

【解決手段】 Oリング押え12を二重構造にして、石
英製ボートキャップ6に接する内側のOリング押え13
はボートキャップ6を損傷しないように弾性のあるテフ
ロン等の樹脂製とし、樹脂製Oリング押え13の外側の
Oリング押え14は、樹脂製Oリング押え13の変形を
防止するためにステンレス等の金属製とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】石英製反応管のフランジの下面に、炉口蓋上に設けた石英製ポートキャップのフランジをＯリングを介して当接可能とし、Ｏリング押えが上記Ｏリングを押えるとともに上記ポートキャップに接してポートキャップを固定するようにした半導体製造装置において、上記Ｏリング押えを二重構造として、Ｏリング及び石英製ポートキャップに接する内側のＯリング押えは樹脂製とし、樹脂製Ｏリングの外側のＯリング押えは金属製とした半導体製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は拡散、化学気相成長を行うための半導体製造装置に係り、特に縦型炉の炉口部をシールするＯリングを押えるＯリング押えに関するものである。

【0002】

【従来の技術】図3で縦型炉を具備した半導体製造装置の概略を説明する。筐体1内部の上方に縦型炉2が設けられ、縦型炉2の下方にポートエレベータ3が設けられる。このポートエレベータ3の昇降スライダ4には炉口蓋5が設けられ、炉口蓋5には石英製のポートキャップ6を介して石英製のポート7が載置される。このポート7には被処理物であるウェーハ8が水平姿勢で多段に挿入され保持される。ポートエレベータ3はウェーハ8が挿入されたポート7を縦型炉2に挿入し、ポート7を挿入することで炉口蓋5で縦型炉2の下部に開口した炉口部を閉塞する。縦型炉2内でウェーハ8に所要の処理がなされ、処理が完了するとポートエレベータ3によりポート7が引き出される。

【0003】上述した縦型炉の炉口部16について図2により説明する。縦型炉を構成する反応管9の内部にポートキャップ6を介してポート7を収納させる。炉口蓋5はポートエレベータ（図示せず）に設けられ、炉口蓋5上には石英製のポートキャップ6が設けられる。反応管9の下端にはフランジ9aが形成され、該フランジ9aはポートキャップ6の下端に形成されたフランジ6aにＯリング10を介して当接可能となっている。このＯリング10は、ポートキャップ6のフランジ6aの周端上部に形成された段差15に設けられる。この段差15に設けられたＯリング10を押し込むために、ポートキャップ6のフランジ6aの外側にＯリング押え11が設けられる。Ｏリング押え11は、また、フランジ6aに接してポートキャップ6を固定する。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】上述したように従来の縦型炉の炉口部16では、石英製ポートキャップ6と石英製反応管9とをＯリング10でシールしているが、このＯリング10を固定するためにＯリング押え11が設けられている。このＯリング押え11は同時に石英製ポ

ートキャップ6を固定する役割を持つため、石英を損傷しない弾性のテフロン等の樹脂で作られている。

【0005】しかし、樹脂で作られているＯリング押え11は高温にさらされるため長時間高温下で使用すると変形し、Ｏリング押え11の交換頻度が多くなり、メンテナンス時間が増加していた。また、変形が高じてＯリング10が外れ、製品ウェーハへの悪影響が出るという問題も起きていた。

【0006】本発明の目的は、上述した従来技術の問題点を解消して、長時間高温下で使用しても反応管の炉口部をシールするＯリングが変形したり、外れたりしないようにした半導体製造装置を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は、石英製反応管のフランジの下面に、炉口蓋上に設けた石英製ポートキャップのフランジをＯリングを介して当接可能とし、Ｏリング押えが上記Ｏリングを押えるとともに上記ポートキャップに接してポートキャップを固定するようにした半導体製造装置において、上記Ｏリング押えを二重構造として、Ｏリング及び石英製ポートキャップに接する内側のＯリング押えは樹脂製とし、樹脂製Ｏリングの外側のＯリング押えは金属製としたものである。

【0008】樹脂製のＯリング押えを金属製のＯリング押えて押えているので、長時間高温下で使用しても樹脂製のＯリング押えは変形せず、Ｏリングが外れるということがない。また石英製ポートキャップは樹脂製のＯリング押えと接しているので破損することもない。

【0009】

【発明の実施の形態】以下に本発明の半導体製造装置の実施形態を説明する。本実施形態の半導体製造装置の基本構造は従来例と同じであり、異なる点は、縦型炉の炉口部のＯリング押えを二重構造とした点である。

【0010】図1に炉口部16の要部図を示す。炉口蓋5上には石英製のポートキャップ6が設けられる。石英製ポートキャップ6のフランジ6aの周端上部に段差15が形成され、その段差15にＯリング10が設けられ、図示しない反応管と炉口蓋5とをシールする。炉口蓋5上の周端に、フランジ6aの周端上部に設けたＯリング10を押え込むと共に、フランジ6aの周端面と接してポートキャップ6を固定するＯリング押え12が設けられる。

【0011】このＯリング押え12は従来樹脂製の単体で構成されていたが、これをテフロン等からなる樹脂製Ｏリング押え13と、ステンレス等からなる金属製Ｏリング押え14との二重構造とする。内側の樹脂製Ｏリング押え13は、その上部でＯリング10と接してＯリング10を押え込むとともに、その下部でポートキャップ6のフランジ6aの周端面と接してポートキャップ6を固定する。外側の金属製Ｏリング押え14は樹脂製Ｏリング押え13と接触して樹脂製Ｏリング押え13の背面

全面を押え込むようになっている。

【0012】このようにリング10及び石英製ポートキャップ6のフランジ6aに接するリング押え13は弾性のある樹脂製とし、その外側を金属製のリング押え14として、金属製リング押え14で樹脂製リング押え13をバックアップするようにしたので、熱による樹脂製リング押え13が変形したり、リング10が外れたりするのを有効に防止することができる。

【0013】なお、上述した実施の形態ではリング押えを二重構造としたが、それ以上の多重構造としてもよい。また、樹脂製リングと金属製リングとは別体としてもよいが、金属製リングの内側に樹脂製リングを密着形成して両者を一体化してもよい。

【0014】

【発明の効果】本発明によれば、リング押えを、樹脂製リング押えと金属製リング押えとからなる二重構造にしたので、長時間高温下で使用してもリング押えが変形したり外れたりすることがなく、また石英製ポー*

*トキャップを破損する虞もない。したがってリングに起因する製品ウェーハへの悪影響がなくなり、リング押えの交換頻度も少なくなり、メンテナンス時間を削減できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態による炉口部のリングによるシール構造の要部を示す断面図である。

【図2】従来例の炉口部のリングによるシール構造を示す断面図である。

10 【図3】縦型炉を有する半導体製造装置の概略を示す斜視図である。

【符号の説明】

5 炉口蓋

6 ポートキャップ

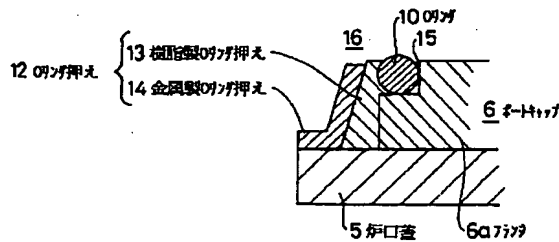
10 リング

12 リング押え

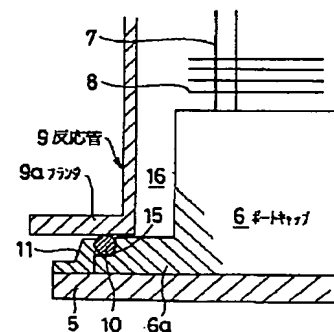
13 樹脂製リング押え

14 金属製リング押え

【図1】



【図2】



【図3】

